

Honor на недавнем мероприятии в Китае впервые показала свой будущий складной смартфон Magic V5. Устройство было спрятано в защитный чехол, но его тонкий корпус и плоские металлические грани всё равно были заметны. Толщина корпуса составит менее 8,93 мм — примерно как монета в один юань, а вес — менее 219 граммов, что делает его одним из самых лёгких и тонких среди складных телефонов.

На тизерах показан золотой вариант устройства с крупным круглым модулем камеры на задней панели. Magic V5 также предложит функции на базе искусственного интеллекта: персональную базу знаний, координацию между несколькими ИИ-модулями и удобную работу с другими устройствами Honor.

Honor показала складной смартфон Magic V5 в защитном чехле



微博 @科技怪咖

Все права защищены

save pdf date >>> 27.01.2026

Honor показала складной смартфон Magic V5 в защитном чехле

Соцсети

По слухам, смартфон получит качественные экраны — внутренний 7,95 дюйма с высоким разрешением и внешний 6,45 дюйма. Также ожидается мощный процессор Snapdragon 8 Elite, аккумулятор на 6100 мА·ч с быстрой зарядкой 80 Вт, камера на 200 Мп, сканер отпечатка на боковой грани и поддержка спутниковых сообщений Beidou. Презентация Magic V5 состоится 2 июля.